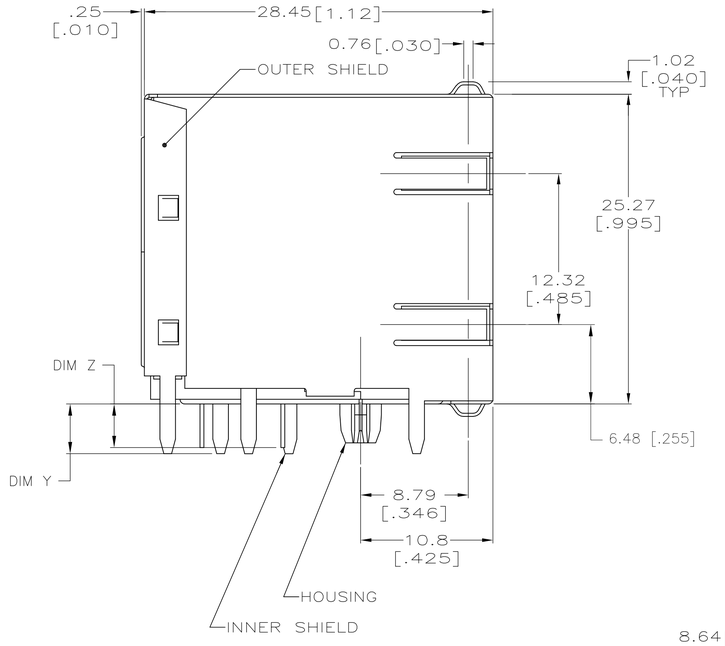
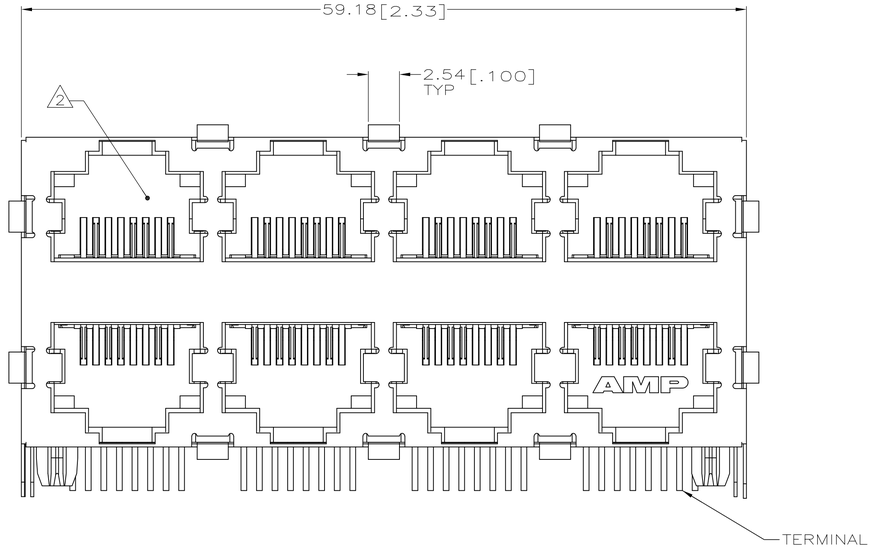
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

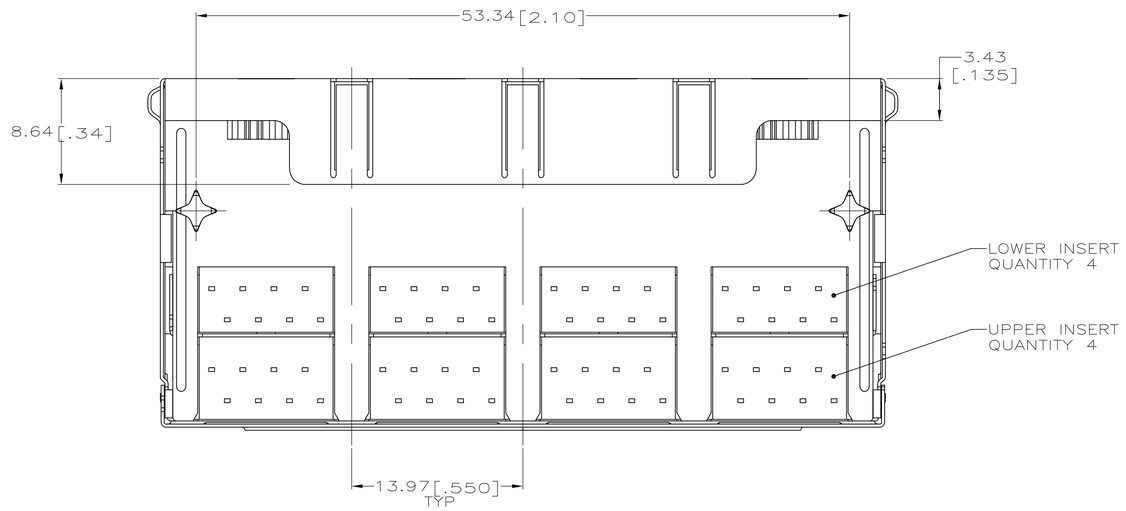
LOC	DIST
AA	22

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED PER ECO-11-005033	26MAR11	RK	HMR





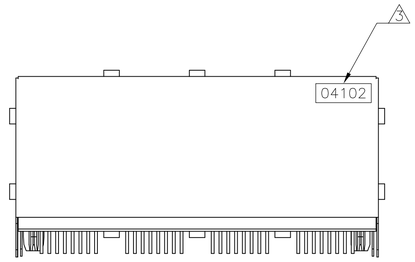


1. MATERIAL:
HOUSING – PCT POLYESTER, BLACK, UL94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRAY – PBT, BROWN.
TERMINALS – 0.33 [.013] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27um [.000050] MIN THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81um [.000150] MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27um [.000050] MIN THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03um [.000080] MIN BRIGHT TIN OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL

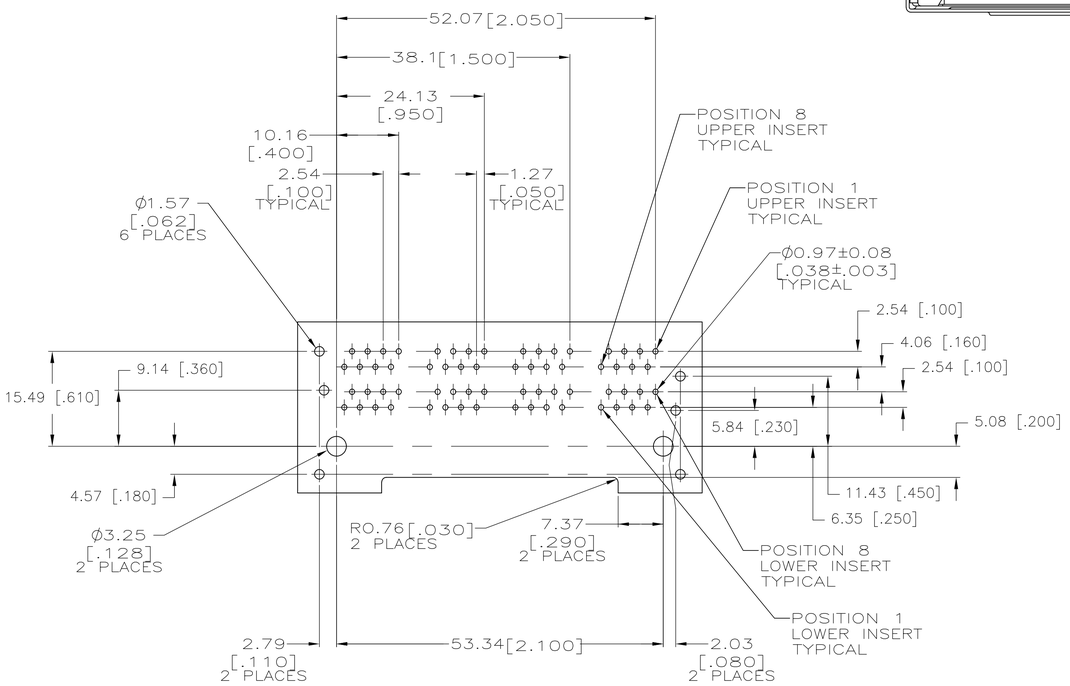
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.

3. DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN:
FIRST 2 DIGITS ARE LAST 2 DIGITS OF YEAR,
SECOND 2 DIGITS ARE MANUFACTURING WORK WEEK,
LAST DIGIT IS DAY OF WEEK, WITH SUNDAY = 1.

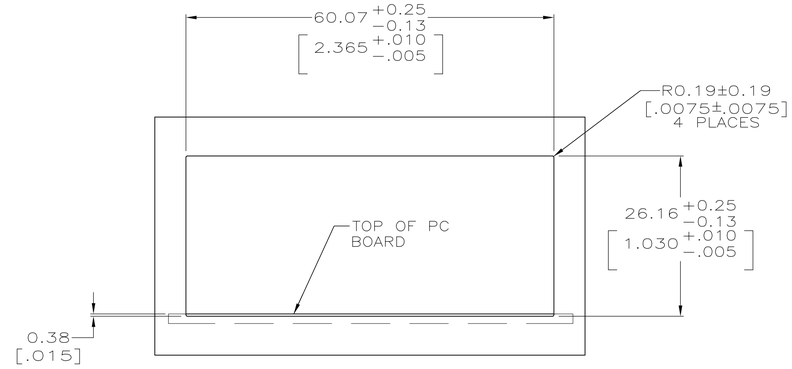
4. MATERIAL:
HOUSING – PCT POLYESTER, BLACK, UL94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRAY – PBT, BROWN.
TERMINALS – 0.33 [.013] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27um [.000050] MIN THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81um [.000150] MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27um [.000050] MIN THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 um [.000050] MINMUM NICKEL AND 2.03 um [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.



BACK VIEW
SCALE 2:1



PC BOARD LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE
SCALE 2:1



SUGGESTED PANEL CUTOUT DIMENSIONS
SCALE 2:1

1	3.05[.120]	4.06[.160]	1-5569262-1
4	3.56[.140]	4.06[.160]	5569262-1
REMARK	DIM. Z	DIM. Y	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.25[.01]
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE NOTE 1
FINISH: SEE NOTE 1

DWN 17APR2005 T. SPRINKLE/L.A.MAYER
CHK 17APR2005 J.WESTMAN
APVD 17APR2005 S.FLICKINGER

PRODUCT SPEC 108-1163-2
APPLICATION SPEC 114-2048
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME: STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2x4 PORT, 8 POSITION, SHIELDED, PANEL GROUND, CATEGORY 5

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-5569262 | RESTRICTED TO –

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B2

4805 (3/11)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9